

2021年10月22日

高性能プリント配線基板用熱可塑性樹脂フィルム「IBUKI™」
高周波特性を向上させた新グレードを開発

三菱ケミカル株式会社

三菱ケミカル株式会社（本社：東京都千代田区、社長：和賀 昌之、以下「当社」）は、プリント配線基板用熱可塑性樹脂フィルム「IBUKI™」について、電気特性を向上させ、高周波領域における伝送損失を低減した新グレード「New-IBUKI™（仮称）」を開発しましたので、お知らせいたします。本年10月27日から29日にかけて東京ビッグサイトにおいて開催される「JPCA Show 2021」に出展し、初めてご紹介する予定です。

「IBUKI™」は、接着剤を用いず一括多層プレス加工を容易にした、プリント配線基板用熱可塑性樹脂フィルムです。優れた寸法安定性、高周波特性、低温加工性、耐熱性、加水分解特性といった特長を有しており、配線基板用絶縁基材などとして使用されています。

今後普及が見込まれる5Gなどの次世代通信においては波長が短い高周波が使われるため、従来の素材では電波を損失させ、通信に支障を来すおそれがあり、新素材の開発が求められています。「New-IBUKI™」は、「IBUKI™」の特長はそのままに、高周波領域における伝送損失を軽減させた製品で、次世代通信用の配線基板材料として活用いただけます。

電子機器の薄型化、小型化、高機能化に伴い、プリント基板は今後ますます高多層化、部品内蔵化が進むと考えられます。当社は、顧客ニーズの多様化・高度化に対応する開発を進めることで、「IBUKI™」シリーズのさらなる普及と、事業の発展を目指してまいります。

以上

【展示概要】展示会名：JPCA Show 2021 (<https://www.jpca-show.com/show2021/jp/exhibition/index.html>)

会期：2021年10月27日（水）～29日（金）各10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南1-3ホール（小間番号：2A-01）

主な出展内容：

- ・「New-IBUKI™」
- ・高耐熱プレスクッション材「珪樹®」・高温で繰り返し使用可能なクッション材
- ・柔軟性エポキシフィルム・・・復元性、耐熱性に優れた柔軟性フィルム

お問合せ先
三菱ケミカル株式会社 広報本部
TEL 03-6748-7161